

第1回 3次元積層 半導体量子イメージセンサ研究会

2017. **1/30** (月)

13:30-17:30

参加費
無料
定員150名

●会場
つくば国際会議場
中会議室202室

招待講演

ウエハ積層を用いた次世代三次元大規模集積技術

東京工業大学 大場 隆之氏

ウルトラメモリ社における3Dメモリへの取組み

ウルトラメモリ(株) 安達 隆郎氏

ソニーの3次元積層型CMOSイメージセンサ

ソニーセミコンダクタソリューションズ(株) 梅林 拓氏

3D-IC Processes for sensors and detectors

東北マイクロテック(株) 元吉 真氏

一般講演

新井 康夫氏(KEK)、菊地 克弥氏(産総研)、池田 誠氏(東大VDEC)



詳細・参加申込

詳細はサイトをご覧ください
[http://rd.kek.jp/project/soi/TIA/
1701_TIA3D.html](http://rd.kek.jp/project/soi/TIA/1701_TIA3D.html)

会場準備の都合上、できるだけ事前申込みをお願いします。

●お問い合わせ

大学共同利用機関法人
高エネルギー加速器研究機構
素粒子原子核研究所
新井康夫 mail: yasuo.arai@kek.jp



主催: TIA連携プログラム探索推進事業「かけはし」:3次元積層半導体量子イメージセンサの調査研究グループ
(高エネルギー加速器研究機構、産業技術総合研究所、東京大学VDEC、筑波大学)
後援: TIA, TIA 光量子計測マネージメント・グループ





第1回

3次元積層半導体量子イメージセンサ研究会

program

13:30 はじめに

高エネルギー加速器研究機構 池田 進

一般講演

13:40 「素粒子実験用2次元検出器と3次元積層への期待」

高エネルギー加速器研究機構 新井 康夫

14:05 「3次元積層技術の実現に向けた産総研における研究開発」

産業技術総合研究所 菊地 克弥

招待講演

14:30 「ウエハ積層を用いた次世代三次元大規模集積技術」

東京工業大学 大場 隆之

15:00 「ウルトラメモリ社における3Dメモリへの取組み」

ウルトラメモリ株式会社 安達 隆郎

15:30 Coffee Break

招待講演

15:50 「ソニーの3次元積層型CMOSイメージセンサ」

ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社 梅林 拓

16:20 「3D-IC Processes for sensors and detectors」

東北マイクロテック株式会社 元吉 真

一般講演

16:50 「多層積層型センサーアレイによる時間・空間分解能向上の検討」

東大VDEC 池田 誠

17:15 まとめ・議論

会場

つくば国際会議場 (エポカルつくば)
〒305-0032 茨城県つくば市竹園 2-20-3
URL: <http://www.epochal.or.jp/>

アクセス

つくばエクスプレス つくば駅より徒歩 10分
会場周辺に有料駐車場あり
<http://www.epochal.or.jp/access/index.html>

